

**2025年度**  
**デバイス実装研究会・第3回フジコミーティング**  
**■プログラム■**

1. 13:00 - 13:05 開会挨拶  
アジア半導体機構 会長 森下 順 (株式会社ウォルツ 代表取締役社長)
2. 13:05 - 14:05 基調講演  
演題:「Cloud AI 時代のメガパッケージ化と材料・装置・プロセスの新展開」  
講師: 3DIC リサーチラボ合同会社 リサーチ&コンサルティング  
テクニカルディレクター 市川 公也氏
3. 14:05 - 14:50 報告1  
演題:「先端半導体パッケージング向け材料イノベーションにおける共創」  
講師: 株式会社レゾナック エレクトロニクス事業本部  
開発センター長 池内 孝敏 氏
4. 14:50 - 15:35 報告2  
演題:「先端パッケージの大判化に適応したモールドイング技術の紹介」  
講師: TOWA 株式会社 営業本部 市場開発部 営業技術課  
GL 林口 慎也 氏
- <ブレイク>
5. 15:50 - 16:35 報告3  
演題:「2nm 時代に向けた半導体パッケージ」  
講師: Rapidus 株式会社  
エンジニアリングセンター・フェロー 野中 敏央 氏
6. 16:35 - 17:20 報告4  
演題:「半導体デバイス向け粘着技術」  
講師: リンテック株式会社 アドバンストマテリアルズ事業部門 事業企画部  
実装技術開発室 末吉 晴樹 氏
7. 17:20 - 17:40 共催挨拶  
「福岡超集積半導体ソリューションセンターの概要紹介」  
公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団 超集積半導体ソリューション部  
部長 小野本 達郎 氏
8. 17:40 - 17:45 閉会挨拶  
アジア半導体機構 副会長 高木 タッド (宏廣新技股份有限公司 處長)

<懇親会> ※講演会が終わり次第、講演会会場近くにて開催いたします。